

Die Einschreibung erfolgt über unser **ConfTool** auf www.conftool.net/imaps-herbsttagung-2019

Für den Nachweis der Mitgliedschaft in der IMAPS-Deutschland tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer bei der Registrierung ein.

TEILNEHMERGEBÜHREN:

€ 140,- IMAPS-Mitglieder

€ 220,- Nichtmitglieder

€ 30,- Studenten

Die Bezahlung der Teilnehmergebühr erfolgt gegen Rechnung.

In der Teilnehmergebühr sind die Tagungsunterlagen, Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Augustiner enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.



Bitte melden Sie sich auf unserer Internetseite an!

www.imaps.de



WEITERE VERANSTALTUNGEN:

EMPC 2019, 16.-19. September 2019

EMPC 2019 Secretariat | IMAPS Italy

Tel. +39 (0)382 309579 | info@empc2019.org |

www.empc2019.org

ESTC 2020, 15.-18. September 2020, Vestfold, Norway

<https://www.estc-conference.net>

ANREISE MIT DER BAHN U. ÖPNV

München Hbf bis Lothstrasse 64

Tram Linie 20/21 in Richtung

Moosach/Westfriedhof bis zur

Haltestelle Lothstrasse



Werbung auf der Internetseite

Wir bieten Ihnen an, auf www.imaps.de Ihre Werbeseiten zu präsentieren. Dazu benötigen wir von Ihnen die Dateiformate Acrobat (.pdf), CorelDraw (.cdr) oder alle Windows-Office-Formate (z. B.: .doc, .ppt), per e-mail.

PREIS: € 120,- für eine A4-Seite

(jede weitere Seite: € 60,-)

Im Preis ist auch ein Link auf Ihre Internetseite unter <http://www.imaps.de> für 1 Jahr enthalten.

INFORMATIONEN + RESERVIERUNG FÜR WERBUNG UND AUSSTELLUNG:

Ernst Eggelaar, MBA
Tel.: +49 8722/9620-0
Email: info@imaps.de

Begleitende Ausstellung

Stand ca. 6 m². Mögliche Ausstattung (bitte mit Anmeldung übermitteln):

- **Tisch** (ca. 120 x 80 cm²) und 2 Stühlen
- **Pinwand** (ca. 120 cm x 120 cm²)
- **230V-ANSCHLUSS**

PREIS: € 790,-

Beinhaltet zusätzlich zum Stand auch die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung für 2 Personen.

ANMELDUNGEN ZUR AUSSTELLUNG

können Sie nur über unsere Internetseite vornehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!



Deutsche IMAPS-Konferenz 2019

Herbstkonferenz
17.-18.10.2019

Hochschule München
Munich University of Applied Sciences
Lothstr. 64
D-80335 München

09:00 – T1-B01: ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG

09:10 Ort: Hörsaal
Martin Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM/IMAPS

09:10 – T1-B02: VORTRAGSRUNDE 1 – AVT: BONDEN

10:25 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM/IMAPS

09:10 Thermosonic Wedge-Wedge-Bonden mit hochdynamisch beheiztem Bondwerkzeug

Andreas Unger, Matthias Hunstig, Michael Brökelmann, Hans Hesse, Hesse GmbH

09:35 Experimentelle Analyse und Modellierung des Verbindungsaufbaus beim Ultraschall-Dickdrahtbonden

Claus Scheidemann, Universität Paderborn, Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik

10:00 Electroplated gold micro studs for direct gold-gold bonding of UV LED chips

Christoph Stölmacker¹, Neysha Lobo Ploch, Andreas Thies, Stefan Hochheim, Jens Christian Raß, Frank Schnieder, Anna Mogilatenko, Jan Ruschel, Tim Kolbe, Steffen Knigge, Sven Einfeldt, ¹Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

10:25 – T1-B05: VORSTELLUNG DER AUSSTELLER

10:45 Ort: Hörsaal
Chair: Dirk Schade, XYZTEC

10:45 – T1-B03: AUSSTELLUNG UND KAFFEPAUSE

11:30 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, Microtronic M.V. GmbH/IMAPS

11:30 – T1-B04: VORTRAGSRUNDE 2 – 12:45 MATERIALCHARAKTERISIERUNG

Ort: Hörsaal
Chair: Jens Müller, TU Ilmenau

11:30 Modellierung und numerische Berechnung des richtungsabhängigen Deformationsverhaltens von Leiterplattenbasismaterialien

Michael Schmidt¹, Youssef Maniar, Alexander Kabakchiev, Roumen Ratchev, Michael Guyenot, Hans Walter, Robert ¹Bosch GmbH, Corporate Sector Research and Advance Engineering, Renningen

11:55 Analyse der Rissneigung von MID-Leiterbahnen durch thermomechanische Beanspruchung

Philipp Braeuer, Patrick Reise, Joerg Franke, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

12:20 Bruchcharakterisierung von MLCCs

Vlad Serea, Steffen Wiese, Universität des Saarlandes

12:45 – T1-B06: MITTAGSPAUSE UND FACHAUSSTELLUNG

13:45 Ort: Foyer

13:45 – T1-B07: VORTRAGSRUNDE 3 – POWER MODULE

15:00 Ort: Hörsaal
Chair: Artem Ivanov, University of Applied Sciences Landshut

13:45 Flexibler Thermokompressionsbonder für Advanced Packaging

Silvia Altenbockum, Ventzeslav Rangelov, ATV Technologie GmbH

14:10 Design options for enhanced cooling of inorganic encapsulated power electronic modules

Stefan Behrendt, Ronald Eisele, Fachhochschule Kiel

14:35 Development of a novel 600V/50A power package with semiconductor chips sandwiched between PCB substrates using double-side Ag-sintering

Vladimir Polezhaev¹, Ankit Bhushan Sharma, Lorenz Litzenberger, Alexander Schiffmacher, Jürgen Wilde, Till Huesgen, ¹Electronics Integration Lab, University of Applied Science Kempten

15:00 – T1-B08: KAFFEPAUSE UND FACHAUSSTELLUNG

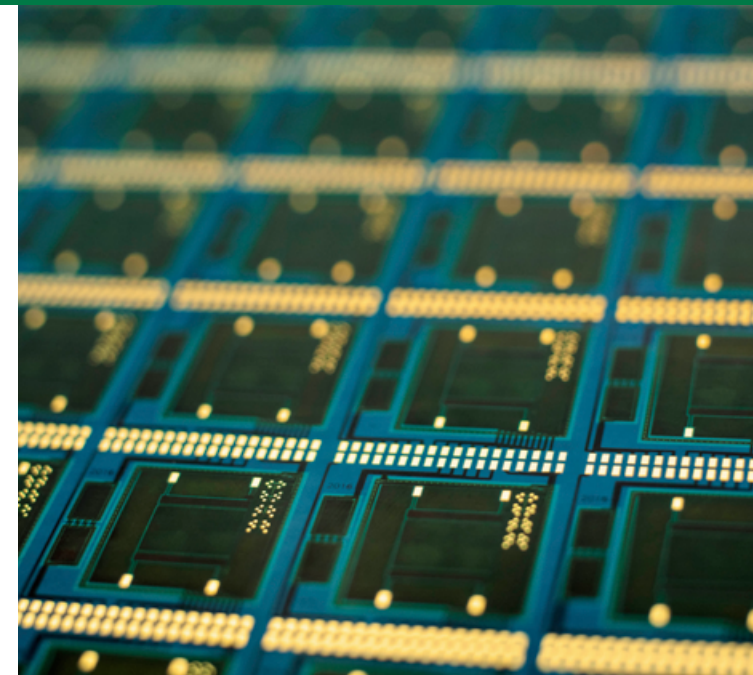
15:35 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, Microtronic M.V. GmbH/IMAPS

15:35 – T1-B09: VORTRAGSRUNDE 4 – AVT: LÖTEN/SINTERN

16:50 Ort: Hörsaal
Chair: Stefan Härter, Siemens AG

15:35 Evaluation von Beschleunigungsmodellen für Lötstellenzuverlässigkeit auf Basis von Lebensdauerdaten aus Temperaturwechselprüfungen

Simon Schambeck¹, Johannes Jaeschke, ¹BMW AG

**16:00 Hybride Kupfer Sinter Paste für Hochtemperaturanwendungen**

Sri Krishna Bhogaraju, Gordon Elger, Omid Mokhtari, Institute of Innovative Mobility (IIMo), Technische Hochschule Ingolstadt

16:25 Flussmittel Systeme in Lotpasten, die Anforderungen an die elektrische Zuverlässigkeit steigen

Andreas Karch, Indium Corporation, Vereinigtes Königreich

17:00 – T1-B10: MITGLIEDERVERSAMMLUNG

18:00 Ort: Hörsaal
Chairs: Martin Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM/IMAPS, Ernst J. M. Eggelaar, Microtronic M.V. GmbH/IMAPS

Ab 19:30 GEMEINSAMES ABENDESSEN IN DEN AUGUSTINER GASTSTÄTTEN

Neuhauser Str. 16, 1. OG, Grüner Saal

09:00 – T2-B01: VORTRAGSRUNDE 5 – ADVANCED SYSTEMS

10:40 Ort: Hörsaal
Chair: Indira Käßlinger, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

09:00 Einzug von Embedded Die und Fan-Out Wafer Level Packaging Technologien in die Volumenfertigung

Steffen Kroehnert, ESPAT-Consulting, Dresden

09:25 Faser-Chipkopplung für optische Mikrosysteme

Möller Christian, Ortlepp Hans-Georg, Käßlinger Indira, Neckermann Kristin, Klein Thomas, Ortlepp Thomas, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

09:50 Alternative Prozessreihenfolge für integrierte mechatronische Module

Julian Schirmer¹, Annette Wimmer, Marcus Reichenberger, Herbert Reichel, ¹Technische Hochschule Nürnberg

10:15 Ein modulares Aufbaukonzept für elektronisch steuerbare, planare Antennenarrays in der Satellitenkommunikation

Peter Uhlig¹, Jens Leiß, Marta Martínez-Vázquez, Constantine Kakoyiannis, Rens Baggen, Ivan Ndip, Christian Tschoban, ¹IMST GmbH

10:40 – T2-B02: AUSSTELLUNG UND KAFFEPAUSE

11:30 Ort: Foyer
Chair: Ernst J. M. Eggelaar, Microtronic M.V. GmbH/IMAPS

11:30 – T2-B03: VORTRAGSRUNDE 6 – ZUVERLÄSSIGKEIT

12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM/IMAPS

11:30 In-line Fehleranalysen auf Basis der Infrarot-Thermografie an Sinter- und Kompositproben

Dan Wargulski¹, Daniel May, Florian Löffler, Torsten Nowak, Jan Petrick, Bernhard Wunderle, Corinna Grosse, Mohamad Abo Ras, ¹Berliner Nanotest und Design GmbH

11:55 Nasschemische Oberflächenmetallisierung – Status und Trends

Ralf Schmidt¹, Felix Fischer, Stefan Schmitz, ¹Fraunhofer IZM

12:20 Zuverlässigkeitssteigerung und Kostenreduzierung beim Ionenäquivalent messen

Helmut Schweigart¹, Ernst Eggelaar, ¹ZESTRON Europe

12:45 – T21-B04: SCHLUSSWORTE UND AUSBLICK

13:00 Ort: Hörsaal
Martin Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM/IMAPS